



C2720C

Avec le projet « Places2Be », l'Europe entend accroître son leadership grâce à l'industrialisation de la technologie FD-SOI, la filière microélectronique la plus rapide, la plus simple et qui dissipe le moins de chaleur

- *D'une durée de trois ans, ce projet de 360 millions d'euros dont STMicroelectronics est le chef de file, implique 19 partenaires européens*
- *Deux lignes-pilotes FD-SOI seront installées à Grenoble et Dresde*
- *Le projet Places2Be est soutenu par la co-entreprise ENIAC et les pouvoirs publics des différents pays*

Bruxelles, le 21 mai 2013 — Le lancement de *Places2Be*, un projet d'une durée de trois ans et d'une valeur de 360 millions d'euros impliquant la construction de lignes-pilotes en technologie avancée afin de soutenir l'industrialisation de la technologie de silicium sur isolant totalement déplétée FD-SOI (*Fully Depleted-Silicon-On-Insulator*), a été annoncé ce jour par un groupement de 19 grandes entreprises et institutions universitaires européennes.

Dirigé par STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, le projet *Places2Be* (« *Pilot Lines for Advanced CMOS Enhanced by SOI in 2x nodes, Built in Europe* ») a pour vocation de soutenir le déploiement d'une ligne-pilote FD-SOI dans les nœuds de 28 nm et suivants, ainsi que d'une deuxième source qui permettra la fabrication en volume en Europe. *Places2Be* favorisera la création d'un écosystème européen dans le domaine de la conception microélectronique en s'appuyant sur cette plate-forme FD-SOI, et explorera la voie à suivre vers la prochaine étape de cette technologie (14/10 nm).

La technologie FD-SOI est une alternative basse consommation et haute performance de nouvelle génération aux traditionnelles technologies silicium et FinFET massives (*bulk*). Les premiers systèmes sur puce réalisés en FD-SOI devraient être utilisés dans des produits électroniques grand public, informatiques de haute performance et de connectivité réseau.

Avec un budget de près de 360 millions d'euros, la participation de 19 partenaires représentant 7 pays et l'implication prévue d'environ 500 ingénieurs sur trois ans à travers l'Europe, *Places2Be* est le plus important projet lancé à ce jour dans le cadre d'un partenariat public-privé (Joint Undertaking — JU) de l'ENIAC, le Conseil consultatif pour l'initiative européenne des nanotechnologies avec le soutien des pouvoirs publics des pays participants. *Places2Be* est l'un des projets de lignes-pilotes de fabrication de technologies clés (KET) octroyés par l'entreprise commune ENIAC-JU pour développer des technologies et des domaines d'application ayant un impact sociétal important.

Les sources de fabrication de la technologie FD-SOI pour ce projet sont implantées dans les deux grands pôles de la microélectronique européenne : la ligne-pilote de STMicroelectronics de l'usine de Crolles, près de Grenoble (Isère), et la deuxième source dans l'usine Fab 1 de GlobalFoundries à Dresde (Allemagne).



« Le projet *Places2Be* va permettre de renforcer les pôles de Grenoble et de Dresde, tout en ayant des répercussions positives sur l'ensemble de la chaîne de valeur microélectronique en Europe — grands comptes, PME, start-ups et autres instituts de recherche — au-delà de l'impact direct induit par les investissements en faveur des matériaux et de la propriété intellectuelle », a déclaré François Finck, directeur des programmes de coopération en R&D de ST et coordinateur du projet.

Note pour les rédacteurs

Membres du projet *Places2Be* (par ordre alphabétique) :

- ACREO Swedish ICT AB, Suède
- Adixen Vacuum Products, France
- Axiom IC, Pays-Bas
- Bruco Integrated Circuits, Pays-Bas
- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, France
- Dolphin Integration, France
- Ericsson AB, Suède
- eSilicon Romania S.r.l., Roumanie
- Forschungszentrum Jülich GmbH, Allemagne
- GlobalFoundries Dresden, Allemagne
- Grenoble INP, France
- IMEC Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw, Belgique
- Ion Beam Services, France
- Mentor Graphics France Sarl, France
- SOITEC SA, France
- ST-Ericsson
- STMicroelectronics (Crolles2 SAS, SA, Grenoble SAS), France
- Université Catholique de Louvain, Belgique
- Université de Twente, Pays-Bas

Pays concernés :

- Allemagne
- Belgique
- Finlande
- France
- Pays-Bas
- Roumanie
- Suède

À propos de la technologie FD-SOI

La technologie sur silicium sur isolant totalement déplétée FD-SOI (« Fully-Depleted Silicon-On-Insulator ») améliore le contrôle électrostatique du canal du transistor, ce qui augmente les performances et le rendement énergétique des transistors. Plus précisément, *Places2Be* utilise la filière FD-SOI Ultra-Thin Body & Buried oxide (UTBB), qui autorise la mise au point dynamique des performances des transistors — de la basse consommation à haute vitesse — en cours de fonctionnement.



Une vidéo présentant cette technologie est disponible sur YouTube : [youtube.com/watch?v=S_wMzAEajO0&feature=share&list=UUU5iH94nyLSQAn6SgDM9laq](https://www.youtube.com/watch?v=S_wMzAEajO0&feature=share&list=UUU5iH94nyLSQAn6SgDM9laq)

À propos de l'entreprise commune ENIAC

L'entreprise commune ENIAC (ENIAC-JU) est un partenariat public-privé impliquant des États membres de l'ENIAC, l'Union européenne et l'Association pour les activités européennes dans le domaine de la nanoélectronique (AENEAS).

Elle coordonne des activités de recherche par le biais d'appels d'offres concurrentiels dans le but de poursuivre l'intégration et la miniaturisation des composants et d'augmenter leurs fonctionnalités. Son objectif est de fournir de nouveaux matériaux, équipements et processus, de nouvelles architectures, des procédés de fabrication innovants, des méthodologies de conception de rupture, de nouveaux conditionnements et méthodes de « systématisation ». Elle appuiera et sera appuyée par des applications high-tech innovantes dans les domaines des communications et de l'informatique, du transport, des soins de santé et du bien-être, de la gestion de l'énergie et de l'environnement, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que des divertissements.

Créée en février 2008, l'entreprise commune ENIAC attribuera des subventions tout au long de l'année 2013. Les projets bénéficiant d'un financement devront être accomplis au plus tard le 31 décembre 2017. La valeur totale des activités de R&D générées dans le cadre de l'entreprise commune ENIAC est estimée à 3 milliards d'euros.

À propos de STMicroelectronics

ST est un leader mondial sur le marché des semi-conducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l'automobile et les solutions de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2012, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com

Contacts presse :

STMicroelectronics

Pascal Boulard
Tél : 01.58.07.75.96
Mobile : 06.14.16.80.17
pascal.boulard@st.com

Nelly Dimey
Director, Corporate Media and Public Relations
Tel: +33 1 58 07 77 85
nelly.dimey@st.com

ENIAC JU

Elodie Michaud
Communication Officer
Tel : +33 1 40 64 45 80
michaud@aeneas-office.eu